附件：

审定、预审和讨论的标准项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 | 会议ID |
|  | 国标委发[2018]60号  20181808-T-469 | [半导体材料术语](http://zxd.sacinfo.org.cn:7001/default/com.sac.tpms.core.common.detailForQuery.projectDetailInfo.flow?projectID=113340&stage=plan) | 有研半导体材料有限公司 | 审定 | 895-7669-5375 |
|  | 国标委发[2021]12号20210892-T-469 | 硅片流动图形缺陷的检测 腐蚀法 | 徐州鑫晶半导体科技有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]12号20210888-T-469 | 碳化硅抛光片表面质量和微管密度的测试 共焦点微分干涉法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 预审 |
|  | 国标委发[2021]41号20214650-T-469 | 硅中代位碳含量的红外吸收测试方法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 讨论 |
|  | 工信厅科函[2021]234号  2021-1248T-YS | 锗行业绿色工厂评价要求 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 预审 |